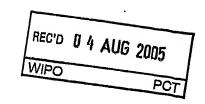
特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]



の告類記号 AY04-0224W01	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/006144	国際出願日 (日. 月. 年) 28. 04. 2004	優先日 (日.月.年) 15.07.2003		
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. ⁷ H01L21/20	3, C30B23/08, H01L21/338, 29/778, 2	9/812		
出願人(氏名又は名称) 株式会社日鉱マテリアルズ				
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条 (PCT36条) σ	の国際予備審査機関で作成された国際 規定に従い送付する。	予備審査報告である。		
2. この国際予備審査報告は、この表紙を		·ジからなる。		
3. この報告には次の附属物件も添付され a. ▼ 附属書類は全部で1	ている。 ページであ <u>る</u> 。	•		
▼ 補正されて、この報告の基 囲及び/又は図面の用紙()	をとされた及び/又はこの国際予備審査 CT規則 70.16 及び実施細則第 607 号	機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 参照)		
「 第 I 欄 4. 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し	たように、出願時における国際出願の 差替え用紙	開示の範囲を超えた補正を含むものとこの		
b. 「電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。				
配列表に関する補充棚に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照)				
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。				
▼ 第 I 禰 国際予備審査報 「 第 I 禰 優先権 「 第 I 禰 新規性、進歩性 「 第 I ▼ 第 I ▼ 第 I ▼ 第 I ▼ 第 I ▼ 第 I ▼ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	又は産業上の利用可能性についての国際	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
▼ 第V欄 発明の単一性の火如 ▼ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを寒付けるための文献及び説明				
第VI概 ある種の引用文献 第VI概 国際出願の不備 第VI概 国際出願に対する意見				
, MANAGER MICHAEL NA	₩ N. 7U			
国際予備審査の請求書を受理した日	国際予備審査報告	を作成した口		
08.03.2005		07. 2005		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官(権			

電話番号 03-3581-1101 内線 3471

郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番3号

第I棡	報告の基礎
1. ະຫ	D国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
7 7 7 2. 20	この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査 の報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出され え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
Γ	出願時の国際出願書類
⊽	明細書 第 1-9 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
V	請求の範囲 項、出願時に提出されたもの 第 3, 4 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 1, 2 項*、08.03.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 1, 2 項*、 08.03.2005 付けで国際予備審査機関が受理したもの
r	図面 第 1/4-4/4 ページ/図、出願時に提出されたもの 第
з. Г	補正により、下記の書類が削除された。 明細書 第
4. F	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c)) □ 明細書 第
* 4	1. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP2004/006144

. 見解		
新規性 (N)	請求の範囲 <u>1-4</u> 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-4</u> 請求の範囲	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-4</u> 請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1: JP 7-86162 A(株式会社日立製作所), 1995.03.31 文献 2: JP 6-97097 A(日本電気株式会社), 1994.04.08

請求の範囲 1-4 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩

性を有する。 文献 1,2 には、III 族元素および第 1 の V 族元素の分子線の照射を停止し、第 1 の V 族元素の供給量が 1/10 以下となるまで成長を中断した後にエッチストッパ膜を成長させ、エッチストッパ膜のエッチング耐性を向上させることについては、記載も示唆もされていない。

請求の範囲

- 1. (補正後)分子線エピタキシャル成長法により I I I ーV族系化合物半導体のヘテロ接合を有する半導体薄膜を形成するエピタキシャル成長方法であって、
- 5 少なくとも一種類以上のIII族元素の分子線と第1のV族元素の分子線とを 照射して第1の化合物半導体層を形成する第1の工程と、

前記III族元素の分子線と前記第1のV族元素の分子線の照射を停止し、前記第1のV族元素の供給量が前記第1の工程における供給量の1/10以下となるまで成長を中断する第2の工程と、

10 少なくとも一種類以上のIII族元素の分子線と第2のV族元素の分子線とを 照射して前記第1の化合物半導体層上に前記第1の化合物半導体とは異なり第2 の化合物半導体層からなるエッチストッパー層を形成する第3の工程と、

を備えることを特徴とするエピタキシャル成長方法。

15 2. (補正後)分子線エピタキシャル成長法により I I I - V 族系化合物半導体のヘテロ接合を有する半導体薄膜を形成するエピタキシャル成長方法であって、少なくとも一種類以上の I I I 族元素の分子線と第1のV 族元素の分子線とを照射して第1の化合物半導体層を形成する第1の工程と、

前記III族元素の分子線と前記第1のV族元素の分子線の照射を停止すると 20 ともに、第2のV族元素の分子線を照射し、前記第1のV族元素の供給量が前記 第1の工程における供給量の1/10以下となるまで成長を中断する第2の工程 と、

さらに、少なくとも一種類以上のIII族元素の分子線を照射して前記第1の 化合物半導体層上に前記第1の化合物半導体とは異なる第2の化合物半導体層か らなるエッチストッパー層を形成する第3の工程と、

を備えることを特徴とするエピタキシャル成長方法。

25

3. 前記第1の化合物半導体層はInAlAs層またはInGaAs層であり、 前記第2の化合物半導体層はInP層またはInGaP層であることを特徴とす